



株式会社バイ・テクノロジー
2026年3月期(第29期) 第3四半期決算

決算説明資料

(2025年4月1日～2025年12月31日)

2026年2月10日

| 目次

2026年3月期(第29期) 第3四半期決算

1. 決算概況
2. 受注高・受注残高
3. 2026年3月期 業績予想と配当
4. ROE目標について
5. 企業価値向上に向けた成長戦略
6. 主要財務データ
7. 補足資料

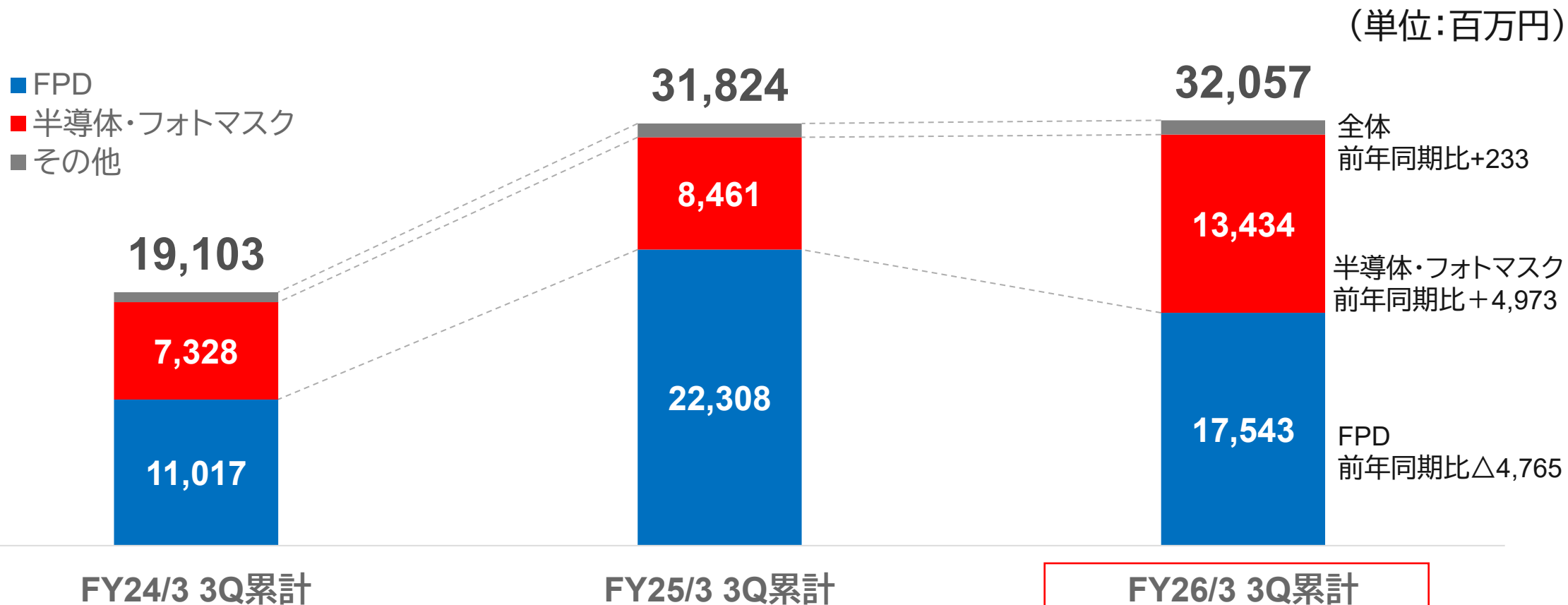
- ✓ 3Q累計の売上高はほぼ前年同期並みながら、営業利益は大幅増を達成
- ✓ 3Q四半期では売上高12,313百万円、前年同期比30%増、営業利益997百万円(前年同期は△80百万円)
- ✓ 3Q累計売上高、営業利益とも年度計画に沿った順調な進捗
- ✓ 子会社清算に伴う繰延税金資産計上に伴い法人税等調整額▲6億円を計上したことで当期純利益が増加

(単位:百万円)	FY24/3 3Q累計	FY25/3 3Q累計	FY26/3 3Q累計	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率
売上高	19,103	31,824	32,057	233	0.7%
営業利益 (△損失)	△2,077	56	627	571	1019.0%
営業利益率	—	0.2%	2.0%		11倍
経常利益 (△損失)	△1,900	194	755	561	289.2%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益(△損失)	△1,387	53	1,304	1,251	2360.4%

セグメント別売上高推移

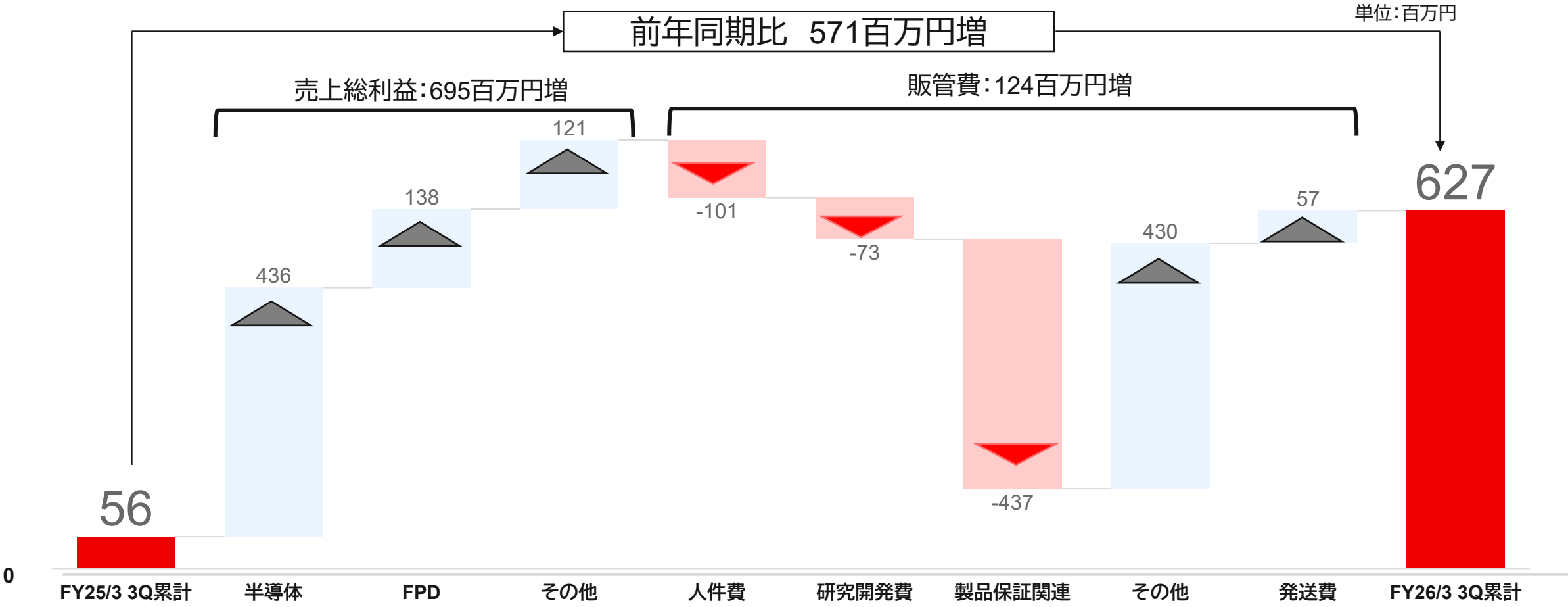
2026年3月期第3四半期決算
1. 決算概況

- ✓ 連結売上高は、成長分野の半導体・フォトマスク事業の拡大がFPD事業の減少を補い、前年同期並みを維持
- ✓ 3Q累計売上高は両事業とも年度計画に沿った進捗



営業利益増減要因(前年同期比)

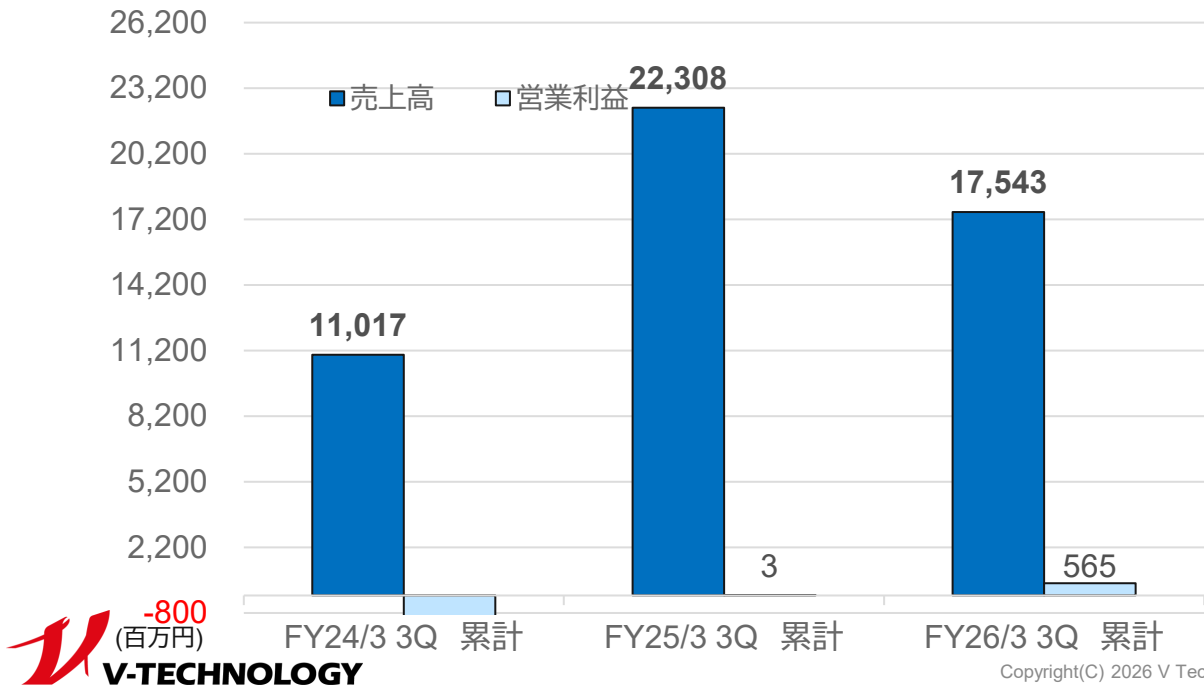
- ✓ 3Q累計の売上総利益は半導体、FPDとも増加
- ✓ 成長ドライバである半導体・フォトマスク装置事業の売上総利益は大幅に改善
- ✓ 販管費は半導体・フォトマスク装置の製品保証関連費用等により増加



FPD装置事業

- 大手顧客向け露光装置の設置が一巡したことで、大幅減収ながら製品ミクス改善により増益

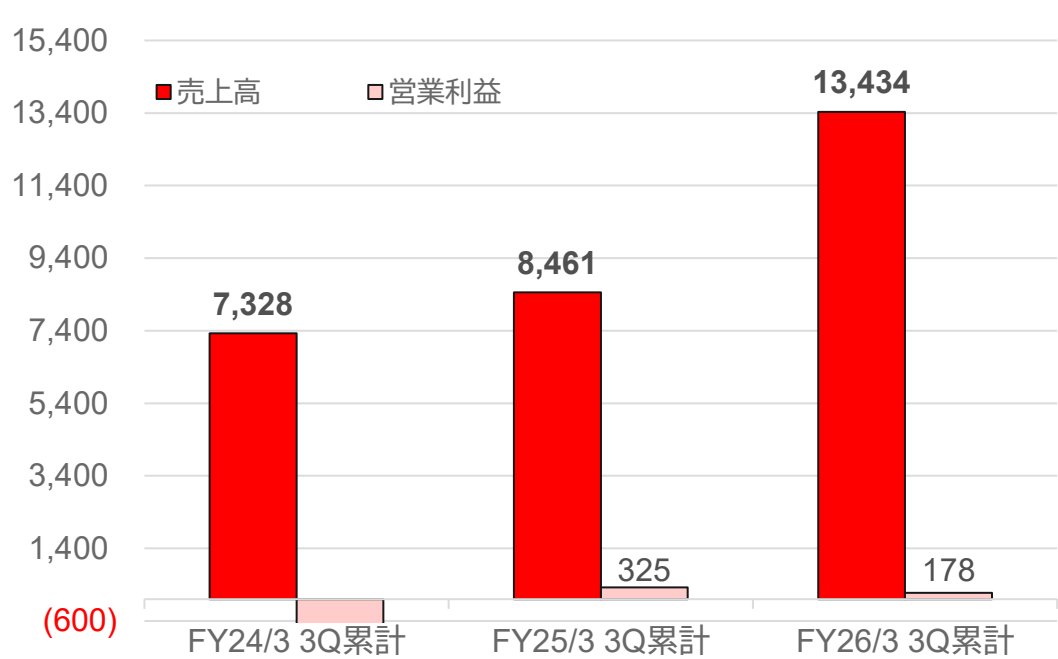
(単位:百万円)	FY24/3 3Q 累計	FY25/3 3Q 累計	FY26/3 3Q 累計	前年同期比	変化率
売上高	11,017	22,308	17,543	△4,765	△21.4%
営業利益	△862	3	565	562	+1,873%



半導体・フォトマスク装置

- 大幅増収により売上総利益は増加したが、製品保証等販管費の増加で営業利益では減益

(単位:百万円)	FY24/3 3Q 累計	FY25/3 3Q 累計	FY26/3 3Q 累計	前年同期比	変化率
売上高	7,328	8,461	13,434	4,973	+ 58.7%
営業利益	△1,017	325	178	△147	△45.2%



受注高・受注残高の概況

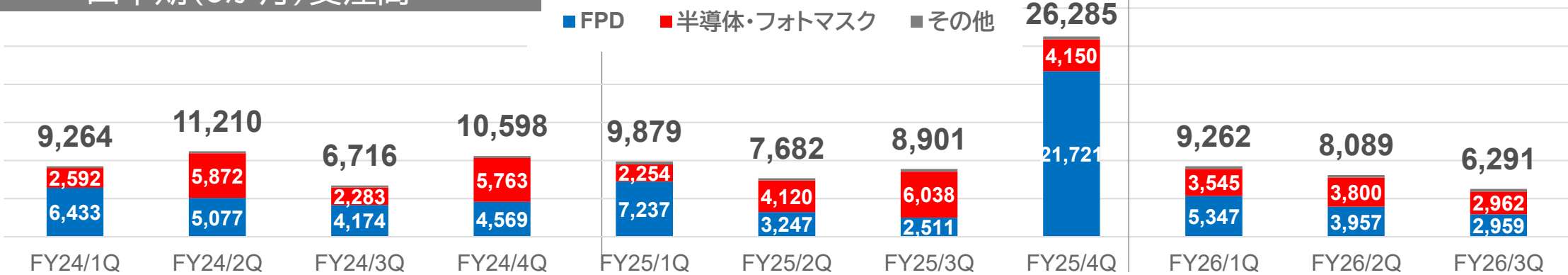
(単位:百万円)		FY25/3 3Q累計	FY26/3 3Q累計	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率	事業概況
全社	受注高	26,462	23,641	△2,821	△11%	期初想定に比べて半導体中心に大型受注案件が4Qに集中
	受注残高	31,737	35,248	3,511	11%	半導体・フォトマスク装置は4Qの受注確定に注力
FPD装置	受注高	12,995	12,268	△727	△6%	前年同期比で、露光装置が減少、メンテナンスが増加
	受注残高	10,586	19,532	8,946	85%	露光・修正装置を中心に、下期の売上計上を想定
半導体・ フォトマスク 装置	受注高	12,412	10,293	△2,119	△17%	フォトマスクの受注が減少。アドバンストパッケージは4Qに案件が集中の見込み
	受注残高	21,151	15,716	△5,435	△26%	来期計画達成に向け、アドバンストパッケージ分野を中心に受注活動に注力

四半期受注高・受注残高の推移

- ✓ FPD装置の大型受注は前期で一巡しており、その後は想定範囲での推移
- ✓ 半導体・フォトマスク装置は3Qまでの進捗はややスローで、大規模案件が4Qに集中する見通し

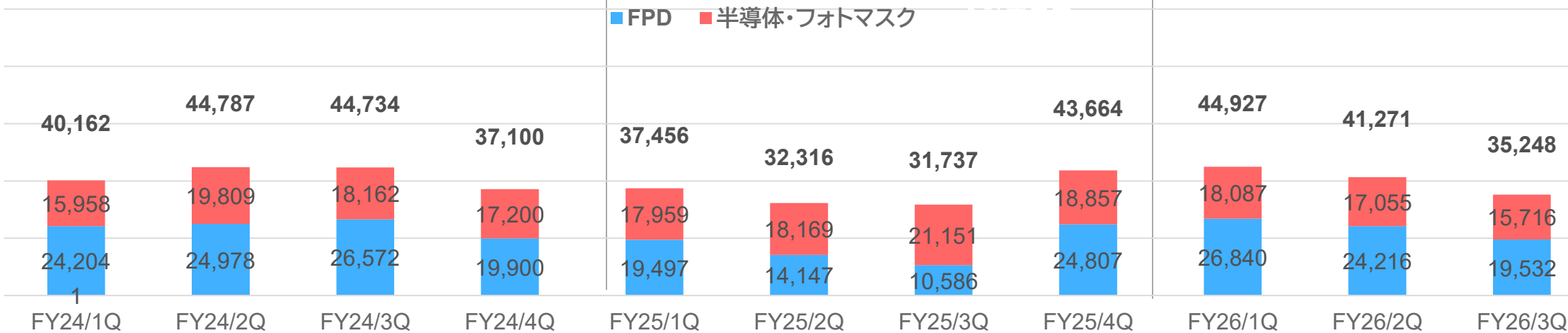
四半期(3か月)受注高

(百万円)



受注残高

(百万円)



2026年3月期業績予想の変更なし

- ✓ 3Qまでの売上、営業利益が会社想定線で進捗
- ✓ 半導体・フォトマスク分野の高採算案件が4Qに寄与する見通しに変更はない
- ✓ 3Qで法人税調整額6億円を計上するも、当該子会社清算に伴う設備減損が4Qで計上される見通しから、年度当期純利益の予想を据え置く

(単位:百万円)	FY25/3 3Q累計	FY25/3通期	FY26/3 (通期予想)	FY26/3 3Q累計	前年同期比 増減金額	前年同期比 増減率
売上高	31,824	46,182	56,000	32,057	233	0.7%
営業利益	56	1,821	4,500	627	571	—
営業利益率	—	3.9%	8.0%	—	—	—
経常利益	194	1,891	4,200	755	561	—
当期(四半期) 純利益	53	800	2,700	1,304	1,251	—

業績計画達成に全社的に取り組むと同時に安定配当を目指す

- 配当政策
 - ✓ 事業拡大に向けたM&A、設備投資等、経営基盤の強化に向けて、必要な内部留保の充実を勘案した上で、配当の安定性・継続性・配当性向等を考慮
 - ✓ 経営成績に応じた利益還元を行なう方針
- 今期配当予想について
 - ✓ 予想の変更無し、中間配当は、当初計画通り。期末配当は、今期業績結果等を踏まえ積極的な利益還元も検討予定
- 株主還元の充実を図るため、機動的な自己株式取得等、引き続き検討

項目		FY21/3	FY22/3	FY23/3	FY24/3	FY25/3	FY26/3(予想)
配当金額(総額/百万円)		1,176	1,176	882	586	764	756
配当性向(%)		21.40	30.60	334.70	74.20	95.20	28.00
一株当たり 配当金(円)	中間	60	60	60	30	40	40
	期末	60	60	30	30	40	40
	総額	120	120	90	60	80	80

FY29/3までにROE20%の達成は最重点目標

2026年3月期第3四半期決算
4. ROE目標について

	FY25/3	FY26/3(予)	FY27/3(予)	FY29/3(予)
ROE	2.4%	8.2%	12.5%	23.7%

1. 最終利益の極大化

✓ 売上高の増加

- 既存ビジネスの伸長、新規ビジネスの取組、M&Aを活用

✓ 利益率UP

- 高利益率事業へのシフト(不採算事業からの撤退、高付加価値製品事業への取組・伸長、中国国産化)
- コストダウン(生産拠点のグローバル化の進展、リードタイム短縮、子会社統合・再編)

2. 株主還元の取組

✓ 利益水準に応じた積極的な配当

✓ 機動的な自社株買い

成長戦略: FPDから半導体へ(1) ～FPD装置事業～

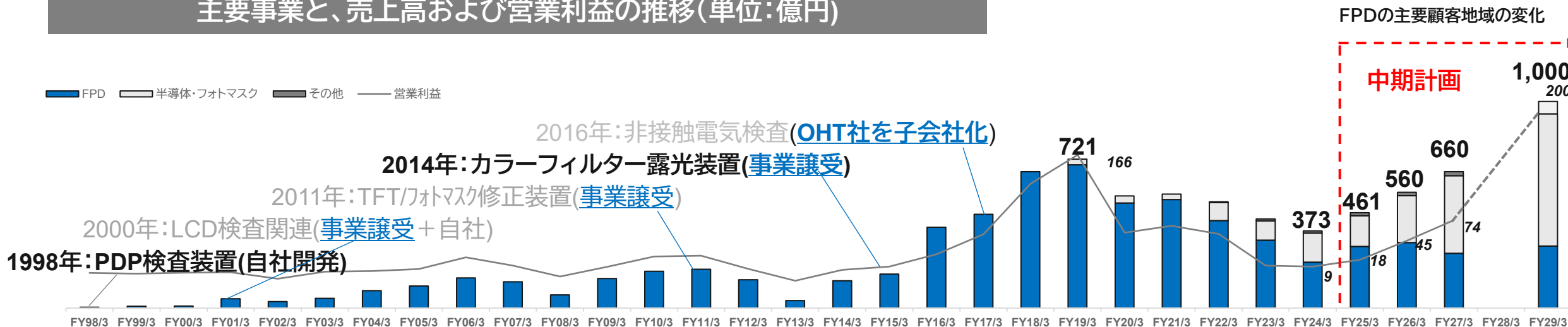
2026年3月期第3四半期決算
5. 企業価値向上に向けた
成長戦略

- ✓ 事業環境が急激に変化する中、FPD装置のM&Aを推進し事業を拡大
- ✓ インド政府がFPD産業への大規模な投資を検討中

産地: 現在のFPDの主要顧客は中国に集中



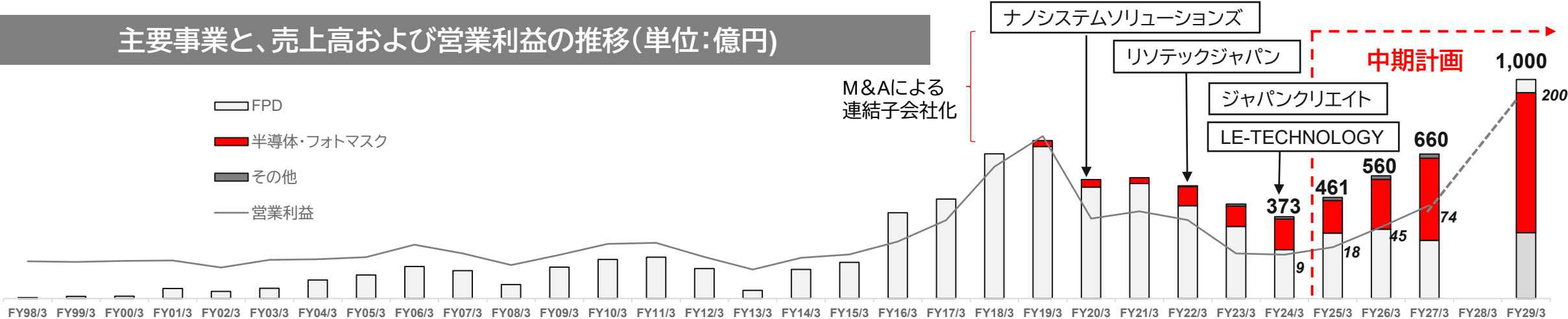
主要事業と、売上高および営業利益の推移(単位: 億円)



半導体に係る日本が強い分野へ参入・・・装置事業は顧客との共同開発が不可欠

参入市場	業界を代表する企業名	当社グループ	主要製品
シリコンウェハ	信越化学工業、SUMCO、他	ナノシステムソリューションズ ジャパンクリエイト	シリコンウェハ検査、洗浄
フォトマスク	テクセンドフォトマスク、DNP、HOYA、他	ブイ・テクノロジー	検査装置(Vテクオリジナル製品)
レジスト材料	東京応化工業、JSR、信越化学工業、住友化学、富士フイルム、他	リソテックジャパン	研究室用レジスト評価装置
アドバンストパッケージ	イビデン、新光電気工業、TOPPANホールディングス、他	LE-TECHNOLOGY オー・エイチ・ティー	DI露光装置、オープンショートテスト、マイクロプローブ

主要事業と、売上高および営業利益の推移(単位:億円)

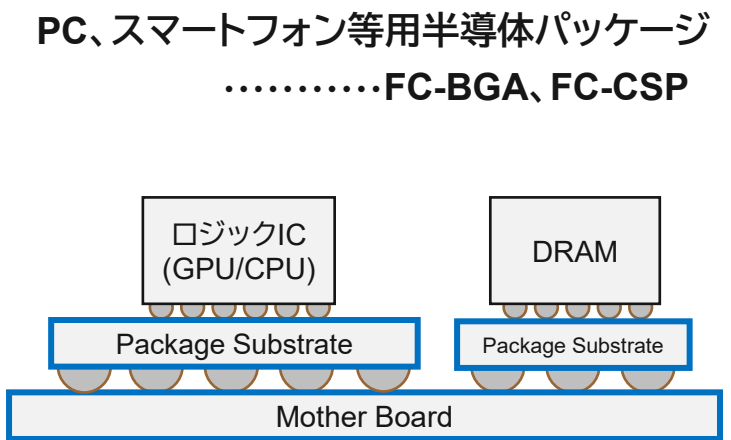
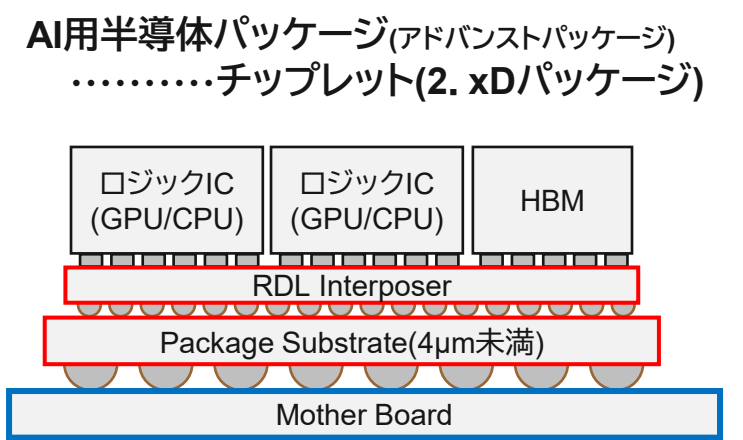


成長戦略: アドバンストパッケージ・PCB

AI用半導体パッケージの分野に集中し、PC・スマホ等向けは協業の方向へ

半導体パッケージ……注力分野(赤枠)と、協業分野(青枠)

PCB……露光工程の周辺にも展開



DI露光装置
CFMEE
芯基微装
中国シェアNo1

+

露光工程周辺
ウェット装置
印刷装置
検査装置、他

露光の周辺工程へリユージョンを展開

アドバンストパッケージ分野における、当社製品の状況				
下記製品が主に関係する最終製品			AI半導体(インターポージャー他)	次世代AI半導体
当社製品	DI露光(LAMBDIシリーズ)		稼働中	2025年7月出荷済
	O/Sテスト	本体(LIBRA)	受注済	開発中
		検査治具(μプローブ)		

成長戦略: フォトマスク(半導体)

採算性を重視しつつ、更新需要に対応

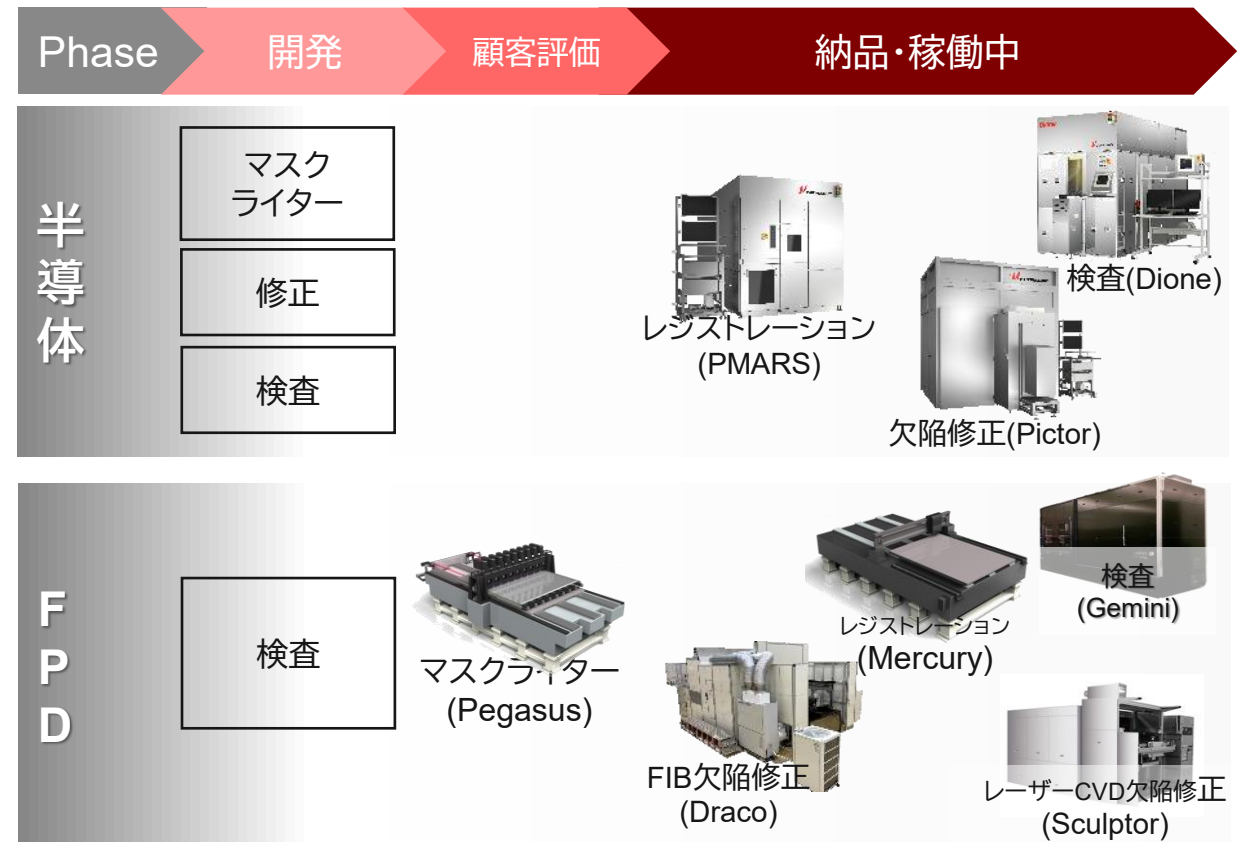
更新需要は一定の規模感で推移する見通し

1. レガシー半導体(パワー半導体、産業用、等)の設備投資は堅調
2. 関連するフォトマスク製造装置の更新に対応
3. 海外展開を強化する一方で、採算性重視で案件を選別



中国無錫
CSEACへ出典

FPDから半導体に製品ラインナップを展開






成長戦略：半導体(ウエハ、フォトレジスト)とFPD装置事業

半導体……主力製品の海外シェア拡大および、新しい分野に向けた新製品の開発

FPD装置事業……トップサプライヤーとしてのポジションを堅持

半導体：主力製品の海外シェア拡大と新製品開発

ナノシステムソリューションズ(NSS)	リソテックジャパン(LTJ)	ジャパנקリエイト(JAC)
主力製品  Siウェハ検査	主力製品  フォトレジスト解析、他	主力製品  ウエハ洗浄・エッチング
開発中(共同評価)  SiC検査装置	新事業(パッケージ技術)  L/S=0.5μm用材料開発用	開発中(ボトル内側)  酸素・水透過防止成膜

FPD装置事業：トップサプライヤーとしてのポジションを堅持

- カラーフィルター用露光装置、検査装置が主力
 - ✓ G10.5用露光装置はシェア100%
 - ✓ キャッシュカウの位置づけ
- 既存工場の能力増強投資は一服
 - ✓ 更新需要への対応力を維持
- 中国現地生産の推進、インド展開の準備

主力製品

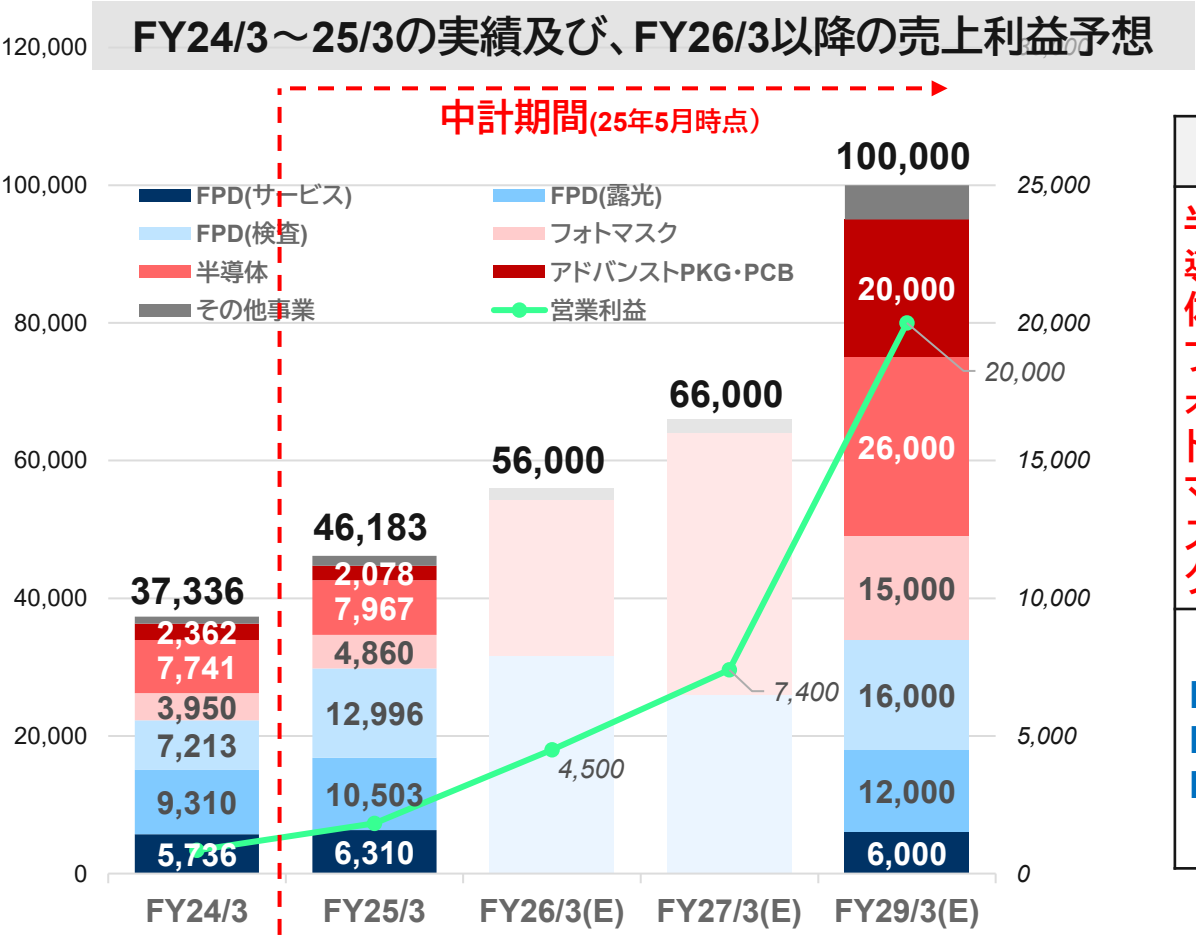
カラーフィルター露光(RZ)

欠陥修正(Jupiter)



成長戦略: 中期経営計画達成に向けて

- 期初の業績予想から変更無し、半導体フォトマスク装置事業、特にアドバンストパッケージ・PCBに注力
- FY27/3以降の成長ドライバ……半導体はNSS新製品、アドバンストパッケージはDI露光装置の成長



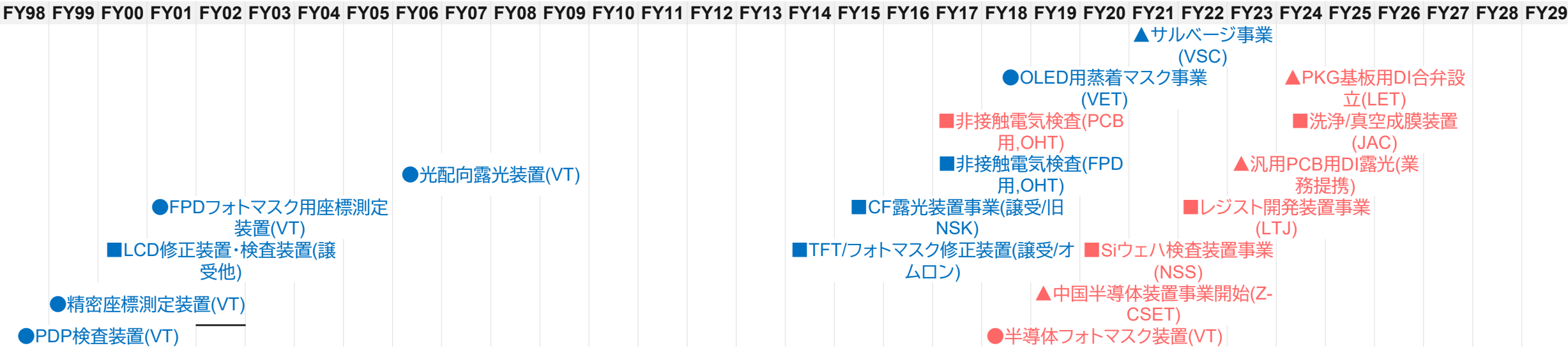
各事業セグメントで狙う市場、主力製品

	セグメント	狙う市場	主力製品
半導体 フォトマスク	アドバンストパッケージ・PCB	・半導体パッケージ基板 ・汎用PCB基板	DI露光、O/Sテスター
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト、他	・検査 ・マスクレス露光 ・コーデベ、他
	フォトマスク	・レガシー半導体 ・FPD	検査、修正、測定、他
FPD	検査	LCD、OLED、他	検査、修正、測定、他
	露光	LCD、他	カラーフィルター露光 光配向露光、他
	アフターサービス	LCD、OLED、他	納入済製品のサービス

FPDから半導体へ ～事業成長と、M&A+R&Dによる製品群拡大の歴史～

2026年3月期第3四半期決算
5.企業価値向上に向けた
成長戦略

M&Aと自社R&Dによる事業拡大の歴史



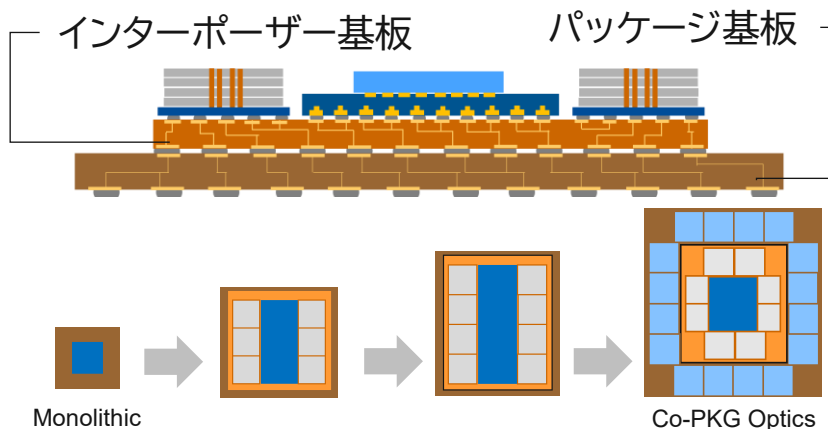
凡例 ●:自社開発／■:M&A／▲:協業／青字:FPD関連／桃色字:半導体関連



AI用半導体パッケージの大型化と当社製品

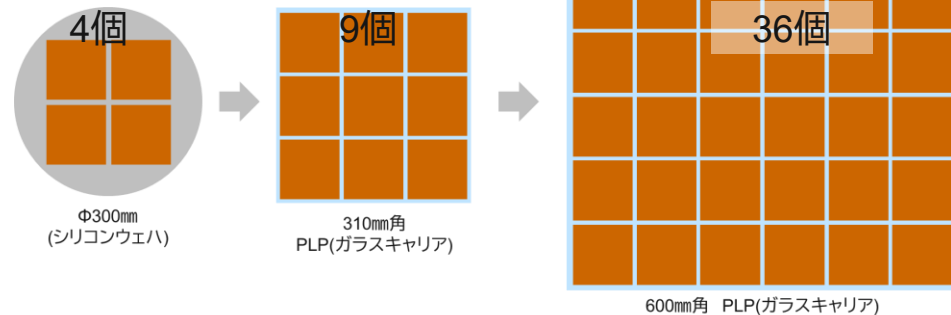
2026年3月期第3四半期決算
5. 企業価値向上に向けた
成長戦略

先端基板の進化(大型化/多層化/微細化)

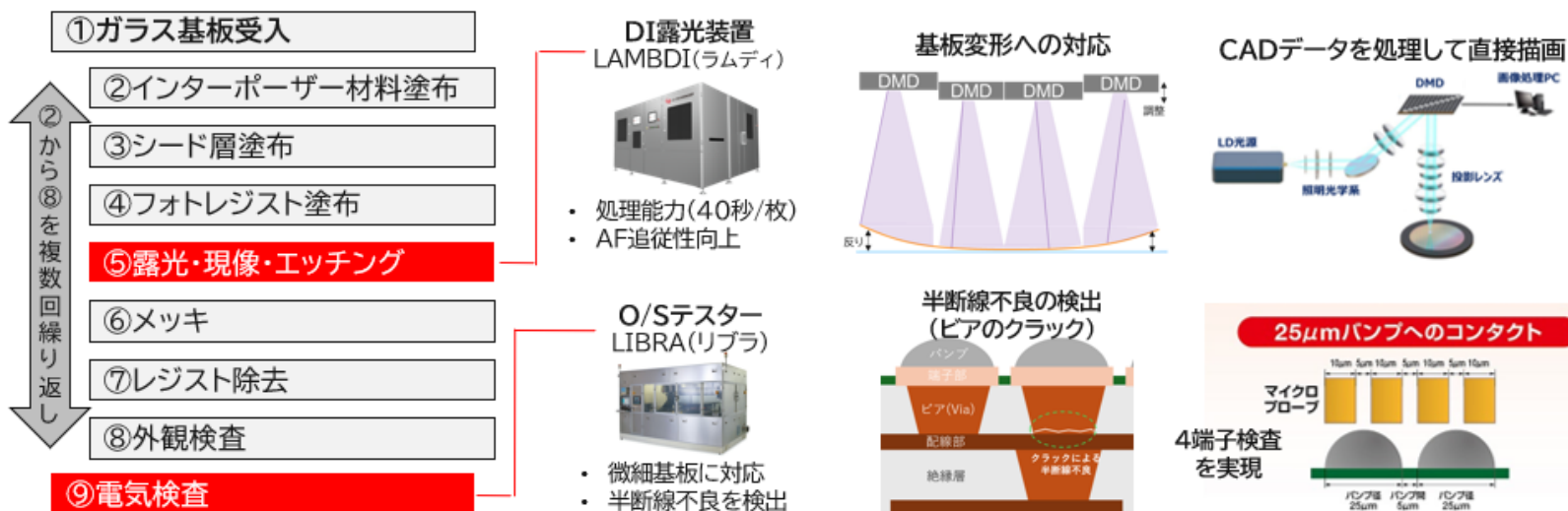


大型化するインターポーザーへの対応(PLPの採用)

反り・歪み・層間位置ずれへの対応が課題に



樹脂インターポーザー製造工程例と、当社製品および特長



1. セグメント別受注高・売上高の詳細 (単位:百万円)

項目	2024/3	2025/3	2026/3	2024/3				2025/3				2026/3				構成比	QoQ%	YoY%
			予想	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q				
受注	37,788	52,747	—	9,264	11,210	6,716	10,598	9,880	7,681	8,901	26,285	9,262	8,089	6,291	100.0%	-22.2%	-29.3%	
FPD装置	20,254	34,716	—	6,433	5,077	4,174	4,569	7,237	3,248	2,511	21,721	5,346	3,957	2,959	47.0%	-25.2%	17.8%	
検査	7,898	13,325	—	1,037	3,604	2,285	973	2,944	1,731	1,137	7,513	1,839	757	1,104	17.5%	45.8%	-2.9%	
製造	6,839	15,168	—	4,339	-1	554	1,948	2,905	0	258	12,005	2,287	1,328	12	0.2%	-99.1%	-95.3%	
メンテナンス	5,517	6,224	—	1,058	1,475	1,336	1,649	1,388	1,516	1,116	2,204	1,220	1,872	1,843	29.3%	-1.5%	65.1%	
半導体・フォトマスク	16,444	16,562	—	2,592	5,872	2,283	5,763	2,255	4,120	6,037	4,151	3,547	3,800	2,962	47.1%	-22.1%	-50.9%	
フォトマスク	6,670	2,645	—	250	2,790	484	3,146	590	700	1,351	4	0	2,040	90	1.4%	-95.6%	-93.3%	
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,549	9,393	—	2,281	1,988	1,299	1,982	960	2,564	3,151	2,719	2,598	1,746	2,533	40.3%	45.1%	-19.6%	
アドバンストパッケージ・PCB	2,226	4,524	—	63	1,095	500	634	705	856	1,536	1,428	949	14	339	5.4%	2321.4%	-77.9%	
その他	1,090	1,469	—	239	261	258	266	388	314	354	413	368	332	370	5.9%	11.4%	4.5%	
半導体・フォトマスク比率	43.5%	31.4%	—	28.0%	52.4%	34.0%	54.4%	22.8%	53.6%	67.8%	15.8%	38.3%	47.0%	47.1%	—	0.1%	-20.7%	
受注残高	37,788	43,664	46,000	40,162	44,787	44,734	37,788	37,456	32,316	31,737	43,664	44,927	41,271	35,248	100.0%	-14.6%	11.1%	
FPD装置	19,899	24,877	—	24,204	24,978	26,571	19,899	19,497	14,147	10,586	24,877	26,840	24,216	19,664	55.8%	-18.8%	85.8%	
半導体・フォトマスク	17,200	18,857	—	15,958	19,809	18,162	17,200	17,959	18,168	21,151	18,857	18,087	17,055	15,584	44.2%	-8.6%	-26.3%	
半導体・フォトマスク比率	45.5%	43.2%	—	39.7%	44.2%	40.6%	45.5%	47.9%	56.2%	66.6%	43.2%	40.3%	41.3%	44.2%	—	2.9%	-22.4%	
売上	37,336	46,183	56,000	5,749	6,585	6,769	18,231	9,523	12,822	9,479	14,358	7,999	11,744	12,315	100.0%	4.9%	29.9%	
FPD装置	22,259	29,809	31,689	4,133	4,303	2,581	11,242	7,639	8,598	6,071	7,501	3,314	6,580	7,510	61.0%	14.1%	23.7%	
検査	7,213	12,996	16,208	197	308	832	5,876	3,648	3,859	2,895	2,594	2,182	3,772	2,417	19.6%	-35.9%	-16.5%	
製造	9,310	10,503	9,333	2,620	2,599	314	3,777	2,591	3,065	1,654	3,193	266	767	3169	25.7%	313.2%	91.6%	
メンテナンス	5,736	6,310	6,148	1,316	1,397	1,435	1,588	1,400	1,674	1,522	1,714	866	2,041	1,924	15.6%	-5.7%	26.4%	
半導体・フォトマスク	14,053	14,905	22,677	1,377	2,020	3,931	6,724	1,495	3,911	3,055	6,444	4,317	4,832	4,435	36.0%	-8.2%	45.2%	
フォトマスク	3,950	4,860	5,360	67	270	862	2,751	734	1,687	985	1,455	1,536	119	700	5.7%	488.2%	-28.9%	
半導体(ウェハ製造、ラボ等)	7,741	7,967	10,115	831	1,377	2,122	3,412	642	2,116	1,542	3,667	1,327	3,758	2,599	21.1%	-30.8%	68.5%	
アドバンストパッケージ・PCB	2,362	2,078	7,202	480	374	947	627	120	108	527	1,323	1,454	955	1,136	9.2%	19.0%	115.6%	
その他	1,024	1,469	1,634	239	261	258	266	388	314	354	413	368	332	370	3.0%	11.4%	4.5%	
半導体・フォトマスク比率	37.6%	32.3%	40.5%	24.0%	30.7%	58.1%	36.9%	15.7%	30.5%	32.2%	44.9%	54.0%	41.1%	36.0%	—	-5.1%	3.8%	

2. 受注高および業績実績とガイダンス (単位:百万円)

項目	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3E 予想	2025/3				2026/3				
										1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	Q/Q%	YoY%
受注高	109,323	47,430	22,532	36,980	53,200	37,072	37,788	52,747	-	9,879	7,682	8,901	26,285	9,262	8,089	6,291	-32.1%	-18.1%
受注残高	115,637	90,935	59,145	40,939	42,721	36,647	37,100	43,664	46,000	37,456	32,316	31,737	43,664	44,928	41,271	35,248	-21.5%	9.1%
売上高	66,067	72,132	54,322	55,186	51,418	43,146	37,335	46,182	56,000	9,523	12,822	9,479	14,358	7,998	11,746	12,313	54.0%	-4.0%
売上総利益	21,321	25,144	15,122	15,704	15,486	10,946	10,604	12,130	-	1,773	3,375	2,547	4,435	1,854	2,658	3,878	109.2%	14.9%
営業利益	12,545	16,628	5,653	6,604	5,461	986	846	1,821	4,500	-948	812	192	1,765	-514	144	997	-	22.8%
営業外収益	55	209	623	395	518	935	551	517	-	287	-154	353	31	139	59	248	78.4%	-261.0%
営業外費用	230	70	121	163	111	222	285	447	-	97	175	76	99	215	19	84	-60.9%	-52.0%
経常利益	12,370	16,767	6,156	6,836	5,868	1,700	1,112	1,891	4,200	-759	484	469	1,697	-589	183	1,161	-	139.9%
税前利益	12,256	16,892	6,191	7,054	6,450	1,571	1,181	1,383	-	-721	504	451	1,149	-633	269	1,417	-	181.2%
法人税等	3,399	4,517	2,054	2,462	2,194	1,434	603	781	-	-6	101	213	473	60	-194	-131	-	-
親会社株主 当期純利益	7,837	10,901	3,251	3,513	4,198	260	778	800	2,700	-656	440	53	747	-665	426	1,304	-	196.4%
1株当たり 当期純利益*	1582.84	2217.48	336.29	363.41	434.21	26.92	80.65	84.07	265.71	-68.22	45.41	5.63	78.44	-70.46	45.13	138.04	-	-
1株当たり配当金	270	320	120	120	120	90	60	80	80	-	40	-	40	-	40	-	-	-
1株当たり純資産	3865.5	5552.32	2926.03	3233.74	3534.4	3475.25	3571.35	3544.98	-	-	-	-	3544.98	-	-	-	-	-
売上高総利益率	32.3%	34.9%	27.8%	28.5%	30.1%	25.4%	28.4%	26.3%	-	18.6%	26.3%	26.9%	30.9%	23.2%	22.6%	31.5%	8.3%	5.2%
売上高営業利益率	19.0%	23.1%	10.4%	12.0%	10.6%	2.3%	2.3%	3.9%	8.0%	-10.0%	6.3%	2.0%	12.3%	-6.4%	1.2%	8.1%	14.5%	1.8%
売上高経常利益率	18.7%	23.2%	11.3%	12.4%	11.4%	3.9%	3.0%	4.1%	7.5%	-8.0%	3.8%	4.9%	11.8%	-7.4%	1.6%	9.4%	16.8%	5.7%
法人税率	27.7%	26.7%	33.2%	34.9%	34.0%	91.3%	51.1%	56.5%	-	0.83%	20.04%	47.23%	41.17%	-9.5%	-72.1%	-9.2%	0.2%	-29.3%
売上高当期純利益率	11.9%	15.1%	6.0%	6.4%	8.2%	0.6%	2.1%	1.7%	4.8%	-6.9%	3.4%	0.6%	5.2%	-8.3%	3.6%	10.6%	18.9%	7.2%
自己資本利益率(ROE)	40.9%	40.6%	11.5%	11.2%	12.7%	0.8%	2.3%	2.4%	8.2%	-2.0%	1.3%	0.2%	2.2%	-2.0%	1.3%	3.8%	5.8%	2.4%
自己資本	19,139	26,844	28,293	31,268	32,980	32,842	34,372	33,500	-	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	33,172	34,699	2,065	1723

3. 貸借対照表・キャッシュフロー計算書 (単位:百万円)

項目	2018/3	2019/3	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2025/3 1Q	2Q	3Q	4Q	2026/3 1Q	2Q	3Q	Q/Q%	YoY%
資産の部																	
現金及び預金	22,281	19,836	12,101	33,278	27,898	26,729	23,096	26,671	25,063	28,930	26,196	26,671	23,129	19,952	23,569	18.1%	-10.0%
受取手形・売掛金	21,019	25,518	24,132	19,329	19,537	22,408	24,716	19,786	20,332	21,681	20,181	19,786	18,085	21,598	19,352	-10.4%	-4.1%
棚卸資産	14,071	24,028	24,854	15,956	11,405	10,089	15,531	15,495	16,408	15,052	17,057	15,495	18,196	18,131	20,600	13.6%	20.8%
商品及び貯蔵品	227	171	123	196	176	338	477	679	443	787	788	679	941	625	1,205	92.8%	52.9%
仕掛品	13,118	22,756	23,126	13,977	9,428	7,219	12,274	10,707	12,881	11,374	12,951	10,707	12,612	13,545	15,750	16.3%	21.6%
原材料及び貯蔵品	726	1,101	1,605	1,783	1,801	2,532	2,780	4,109	3,084	2,891	3,318	4,109	4,643	3,961	3,645	-8.0%	9.9%
流動資産	62,209	74,699	66,494	71,379	63,085	62,621	67,045	65,392	65,537	69,073	67,255	65,392	62,922	63,018	67,440	7.0%	0.3%
有形固定資産	977	3,274	4,539	4,382	4,720	4,034	4,098	3,859	4,305	4,261	4,221	3,859	4,403	4,443	4,325	-2.7%	2.5%
無形固定資産	253	189	1,592	1,625	1,495	1,460	886	712	1,000	957	879	712	648	586	537	-8.4%	-38.9%
投資その他の資産	1,344	2,141	2,493	3,203	3,300	3,270	3,575	3,235	3,553	3,190	3,105	3,235	3,157	3,619	4,419	22.1%	42.3%
資産合計	64,786	80,304	75,119	80,591	72,601	71,387	75,606	73,201	74,397	77,483	75,461	73,201	71,132	71,668	76,721	7.1%	1.7%
負債の部																	
支払手形・買掛金	10,861	12,505	8,095	6,477	6,323	4,039	5,429	4,918	5,296	4,778	4,932	4,918	5,735	5,031	6,018	19.6%	22.0%
短期借入金	2,491	2,450	200	120	394	663	866	1,295	1,386	1,704	1,685	1,295	1,297	1,868	1,784	-4.5%	5.9%
前受金	14,868	22,320	18,202	15,061	8,334	8,221	4,496	5,037	5,645	5,638	5,113	5,037	5,563	5,892	5,752	-2.4%	12.5%
流動負債	40,963	50,517	36,539	34,195	27,061	23,922	29,299	24,263	29,905	26,474	25,650	24,263	24,404	25,078	27,054	7.9%	5.5%
長期借入金	2,256	1,332	8,861	12,964	10,243	12,662	10,550	14,254	9,482	16,745	15,420	14,254	12,819	12,167	13,698	12.6%	-11.2%
純資産	21,114	27,985	29,361	32,195	34,540	33,884	34,639	33,581	33,841	33,154	33,300	33,581	32,691	33,258	34,771	4.5%	4.4%
自己資本	19,139	26,844	28,293	31,268	34,175	33,604	34,372	33,500	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	33,172	34,699	4.6%	4.7%
連結CF																	
営業活動によるCF	8,526	6,531	-7,853	20,173	1,408	-3,284	-4,764	5,344	—	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動によるCF	-434	-2,617	-3,828	-1,251	-1,554	-1,195	-440	-1,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フリーキャッシュ・フロー	8,092	3,914	-11,681	18,922	-146	-4,479	-5,204	3,874	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自己株式取得	-	-1,999	0	-512	0	0	-99	-499	—	—	—	—	—	—	—	—	—
配当金支払額	-866	-1,634	-1,547	-974	-1,176	-1,176	-588	-675	—	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動によるCF	-2,150	-6,385	4,074	1,972	-5,839	2,780	1,526	-471	—	—	—	—	—	—	—	—	—

事業セグメント	サブセグメント	関連市場	主力製品	バイ・テクノロジーグループ
半導体・ フォトマスク	アドバンストパッケージ・ PCB	・アドバンストパッケージ ・汎用PCB基板	・DI露光 ・O/Sテスター	<ul style="list-style-type: none"> ・ LE-TECHNOLOGY ・ オー・エイチ・ティー ・ バイ・テクノロジー
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト ・半導体試作、他	・検査 ・ラボ用現像 ・マスクレス露光、他	<ul style="list-style-type: none"> ・ ナノシステムソリューションズ ・ リソテックジャパン ・ ジャパンクリエイト
	フォトマスク	・レガシー半導体用フォトマスク ・FPD用フォトマスク	検査関連、他	バイ・テクノロジー
FPD	検査	LCD、OLED、その他の用途	検査関連、他	<ul style="list-style-type: none"> ・ バイ・テクノロジー ・ オー・エイチ・ティー
	露光	LCD、その他の用途	カラーフィルター露光、 光配向露光、他	バイ・テクノロジー
	アフターサービス	LCD、OLED、その他の用途	製品のサービス、他	バイ・テクノロジー、他

注記事項

・将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

・数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

・事業セグメントの構成

✓ 半導体・フォトマスク装置事業

半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成されています。

✓ FPD装置事業

FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成されています。

お問合せ先
IR室
vtj-ir@vtec.co.jp

